

Qsil553导热灌封硅胶

产品名称	Qsil553导热灌封硅胶
公司名称	深圳市上乘科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区新闻路中电信息大厦1715
联系电话	86-075583466458/83463989 13590173773

产品详情

[QSIL553](#)

是一种A、B双组份硅胶，A、B按1：1混合使用,混合后液体会固化成灰色的柔软弹性体,其粘度低，可修复性强，耐高温，最高可达204度，并具有很好的阻燃型，高绝缘性，导热性及抗硫化返原的特点。100%固体无溶剂，低模量，操作时间长，延伸性好。胶料在常温条件下混合后存放时间较长，但在加热条件下可快速固化，特别利于自动生产线上的使用。耐温性，耐高温老化性好。固化后在在很宽的温度范围（-60~204℃）内保持橡胶弹性，绝缘性能优异。固化过程中不收缩，具有更优的防水防潮和抗老化性能，[具有阻燃性，阻燃性能达到](#) UL94-V0级。用于有大功率电子元器件，对散热和耐温要求较高的模块电源和线路板的灌封保护。